

## 北京赛微电子股份有限公司

### 关于控股子公司 8 英寸 MEMS 国际代工线（一期）投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）在北京经济技术开发区投资建设的“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”（FAB3）（公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目）的主厂房、各支持建筑层区以及一期产能所涉及的产线及超净间已经建成并达到投产条件，现正式通线投产运行。

赛莱克斯北京是由公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资的 8 英寸 MEMS 国际代工线（FAB3）项目公司，主要从事 MEMS 芯片的生产代工业务。赛莱克斯北京建设的该 8 英寸 MEMS 国际代工线依托于公司全资子公司 Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典 Silex”）（FAB1&FAB2）成熟的制造技术和生产管理模式，打造代表业界领先水平的 MEMS 产业化平台。该 8 英寸 MEMS 国际代工线一期产能为 1 万片/月，该部分产能的投产将开始为公司 MEMS 业务提供标准化的规模产能，与瑞典 Silex 进行协同互补，可进一步满足全球各领域客户对 MEMS 工艺开发及晶圆制造不断增长的需求，增强公司在 MEMS 领域的全球市场竞争力。

公司北京 MEMS 产线为新建产线，从投产运行到良率提升、全面达产尚需一定时间；且公司拟通过向特定对象发行股票募集资金继续投入进行后期扩产，对赛莱克斯北京经营业绩产生综合影响。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 27 日